

LAMINA DE RESPUESTO PARA PLACA FRÍA COMPATIBLE CON P1P, P1S, X1C Y X1E

FAP001-1



Descripción:

Lamina de repuesto para la placa fría de impresoras 3D Bambu Lab P1P, P1S, X1C y X1E.

Configuraciones recomendadas:

Tenga en cuenta que es posible que sea necesario ajustar otros parámetros del slicer según el modelo impreso y los requisitos del filamento.

Materiales	Temperatura de la cama caliente	¿Se necesita barra de pegamento?	¿Se quitó la placa de cubierta de vidrio superior?
PLA/PLA-CF/PLA-GF	35 ~ 45 °C	Sí	Cualquiera
TPU	30 ~ 35 °C	Sí	Cualquiera
PVA	30 ~ 45 °C	Sí	Cualquiera

Instalación:

<https://youtu.be/W1EMD77gOkQ>.



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos
Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez
Fecha	22/01/2025

